

エレクトロテスト・ジャパンに出展します。
【出展ブース】 東ホール 24-18

WIT 株式会社
<http://www.witjpn.com>

〒270-0163 千葉県流山市南流山8-1-5
TEL: 04-7140-6085 FAX: 04-7140-6086

中京事業所 ※2014年1月オープン
 〒515-0011 三重県松阪市高町198-1
TEL: 0598-30-6595 FAX: 0598-30-6597

- 中国現地法人 (上海)
 TEL: +86-21-6553-5500 FAX: +86-21-6552-7706
- 中国現地法人 (深圳)
 TEL: +86-755-8346-1500 FAX: +86-755-8346-1639
- タイ現地法人 (バンコク)
 TEL: +66-2237-2479 FAX: +66-2238-2024
- ベトナム現地法人 (ハノイ)
 TEL: +84-4-66843725 FAX: +84-4-37183163

開発・設計に不可欠

モノづくりを支える技術

「第31回エレクトロニクス・ジャパン・エレクトロニクス検査・試験・測定・分析技術展」はエレクトロニクス実装、半導体、基板製造に関する検査・試験・測定・分析機器の専門展示会。主な出展内容は外観・X線検査装置、テスター、環境試験・信頼性試験装置、各種分析装置などの多様な検査・試験装置が

出展する。来場者にとって製品を導入・検討する絶好の場として定着している。会場は東芝ビル3ホール。

スマートフォンやタブレット端末（携帯型情報機器）の普及が加速している。こうした各種モバイル機器の多機能化、小型・軽量・薄型化は実装の高密度・超精密化や半導体の高集積化によって

もたらされている。高度な製造技術が要求される電気・電子機器の製造ラインで、検査・測定機器が果たす役割は大きい。不良品発生の低減・歩留まりの向上は製造の低コスト化、高効率化につながるから、研究開発・設計に欠かせない試験・分析機器は日本のモノづくりを支えている。

同展の主な出展内容は

①外観検査装置②実装基板外観検査装置 ハンダ外観検査装置 赤外線検査装置、X線検査装置、テープ自動ボンディング（TAB）外観検査装置、半導体チップ外観検査装置など③リワーク／リペア装置④テスター／インサーキットテスター、ファンクションテスター、IC／LSエスタターなど⑤検査関連部品⑥治具、プローブ、ステージなど⑦測定・試験・分析機器⑧2、3次元測定機器、膜厚測定機器、恒温・恒湿試験装置、各種環境試験装置、材料試験装置など⑨分析受託装置

①外観検査装置②実装基板外観検査装置 ハンダ外観検査装置 赤外線検査装置、X線・ガンマ線検査、超音波探傷検査、浸透探傷検査などが展示される。①画像処理ソフト、②産業用カメラ、③システムなど画像処理に特化した機器、④技術を一堂に展示、⑤系の電荷結合素子（CCD）カメラ・レンズなどに、処理系の画像処理装置、⑥ポード・ソフトから出力系のモニター・ディスプレイまであらゆる画像処理技術・機器が集結し、来場者の注目を集めた。

Lasertec

Laser + Color Confocal

次世代レーザーマイクロスコープ誕生。

NEW

ハイブリッドレーザーマイクロスコープ

OPTELCICS HYBRID

世界初のHYBRID光学系マイクロスコープ！2つの光学系の採用で用途がさらに拡大

レーザーマイクロスコープ

- 高倍率/高分解能
- 高精度3D測定

カラーコンフォーカル

- 広視野
- リアルカラー
- 豊富なアプリケーション

■すべての機能を1台で

5つの測定機能と高度な連携で、あらゆる観察・測定領域を網羅

レーザー マイクロスコープ

カラー コンフォーカル

OPTELCICS HYBRID

光干渉 形状測定器

反射分光 膜厚測定器

AFM

本展コン ジャパン 2014 内

エレクトロテスト ジャパン
エレクトロニクス検査・試験・測定・分析技術展

レーザーテックは「エレクトロテスト ジャパン展」に出展いたします。

- 会 期: 2014年1月15日(水)～17日(金)
10:00～18:00(最終日は17:00終了)
- 会 場: 東京ビッグサイト

ブースNo:
東27-11

レーザーテック株式会社

www.Lasertec.co.jp

□本 社: 〒222-8552 横浜市港北区新横浜2-10-1 TEL: 045-478-7111 FAX: 045-476-1061